

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2024-044

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额：沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）不变，拟派发现金红利总额由 27,565,308.20 元（含税）调整至 27,616,820.80 元（含税）；

● 资本公积转增股本总额：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，拟转增股本的数量由 62,021,943 股调整至 62,137,847 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）；

● 本次调整原因：自公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项及股权激励归属事项，致使可参与权益分派的股份数量发生变动。公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则，对公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 137,887,011 股，扣除回购专用证券账户中股份数 60,470 股后的剩余股份总数为 137,826,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,565,308.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 137,887,011 股，扣除回购专用证券账户中股份数 60,470 股后的剩余股份总数为 137,826,541 股，合计转增 62,021,943 股，转增后公司的总股本增加至 199,908,954 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

二、本次调整原因

（一）股份回购

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。

另外，自公司 2023 年年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份 42,137 股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为 102,607 股。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》。

（二）股权激励归属导致股份增加

公司于 2024 年 5 月 28 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次、预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，新增股份 299,700 股，公司股本总数由 137,887,011 股增加至 138,186,711 股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

三、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

根据 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过的《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则，对公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。具体调整如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 138,186,711 股，扣除回购专用证券账户中股份数 102,607 股后的剩余股份总数为 138,084,104 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,616,820.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 11%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。截至本公告日，公司总股本为 138,186,711 股，扣除回购专用证券账户中股份数 102,607 股后的剩余股份总数为 138,084,104 股，合计转增 62,137,847 股，转增后公司的总股本增加至 200,324,558 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日